

# 第82期 報告書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで



新光電気工業株式会社

証券コード6967



株主の皆様には、平素よりひとかたならぬご支援を賜り厚く御礼申しあげます。第82期報告書をお届けするにあたり、一言ご挨拶申しあげます。

代表取締役会長兼社長

豊 木 則 行



エレクトロニクス化が一層進展する自動車や急速な拡大が想定されるIoT関連市場、また、人々の健康や生活を支える医療・ヘルスケア分野など、半導体は、その頭脳として用途を広げ、今後も市場を拡大することが見込まれています。さらに、ビッグデータ、人工知能などの広がりが、経済や社会の仕組みに変化をもたらし、これまでとは次元の異なるイノベーションを生み出す可能性を秘めており、半導体は、その可能性を実現するキーテクノロジーとして革新を続けていくことが期待されています。

当社グループは、半導体実装のさまざまな要素技術を時代のニーズに応じて深化・発展させることにより、半導体後工程のトータルソリューションを提供する企業として事業を展開してまいりま

した。今後も、半導体デバイスの優れた機能を人々の生活のなかへともたすインターコネクトテクノロジーをベースに、高い競争力を持つ製品の開発に努め、ものづくりの革新に継続的に取り組むことにより、強固な企業基盤の確立をはかってまいります。

さらに、当社グループの企業理念・指針である「SHINKO Way」の実践を通じ、持続的に企業価値を向上させ、社会の健全な発展に寄与するとともに、社会において必要とされる企業であり続けるべく、事業を展開してまいります。

株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

平成29年6月

### ■ 平成28年度の事業概況

当期の半導体業界は、クラウドサービスの浸透などによりメモリー需要が伸長するとともに、エレクトロニクス化がさらに進展する自動車向けが拡大した一方、スマートフォンの成長鈍化や、パソコン市場の低迷継続等の影響を受けました。

このような環境の下、当社グループでは、成長市場向けに重点的に経営資源を投下し、新製品の市場投入、生産体制強化に注力するとともに、積極的な販売活動を展開し、生産性向上の取り組みを強化した結果、ハイエンドスマートフォン・自動車等向けのIC組立、メモリー向けプラスチックBGA基板の需要が拡大し、スマートフォン等向けにリードフレームの売上が増加しました。一方、フリップチップタイプパッケージはパソコン向けが低調に推移したことなどにより、当期の連結売上高は1,398億90百万円（対前期比2.5%減）となりました。収益面については、フリップチップタイプパッケージの減収ならびに為替相場が円高傾向で推移したことなどの影響を受け、経常利益は34億68百万円（対前期比65.8%減）、親会社株主に帰属する当期純利益は30億7百万円（同13.5%減）となりました。

単独決算につきましては、売上高1,325億4百万円（対前期比1.8%減）、経常利益32億47百万円（同65.2%減）、当期純利益31億73百万円（同7.3%増）を計上いたしました。なお、当期の配当につきましては、期末配当金を12円50銭とし、中間配当金の12円50銭とあわせて年間25円とさせていただきます。

### ■ 今後の見通し

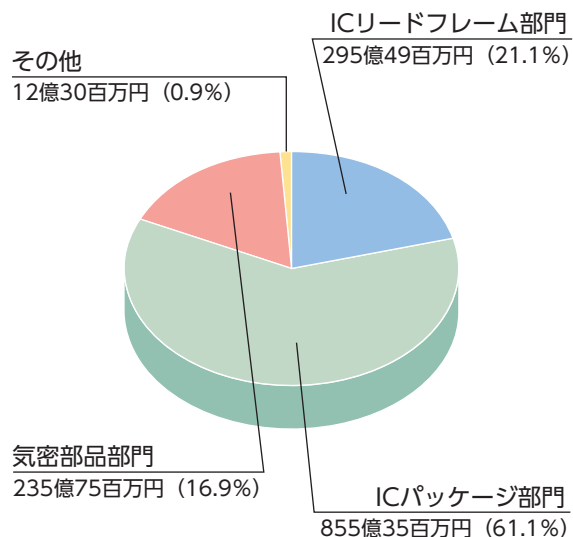
今後の半導体業界は、自動車向けやIoT関連市場向けなどにおいて需要増加が想定される一方、これら成長分野では企業間の競争の一層激化が見込まれ、また、パソコン市場向けは低調に推移し、スマートフォン市場は成長鈍化が継続するとともに、製品の世代交代等に伴い需要が変動するなど、厳しい事業環境が続くものと想定されます。

このような環境の下、当社グループは、自動車、先端メモリー、半導体製造装置関連をはじめとする成長市場向けに引き続き重点的に経営資源を投下し、生産体制の強化をはかるなど、販売拡大に努めてまいります。その一環として、セラミック静電チャックの旺盛な需要に対応すべく、新井工場（新潟県妙高市）に建設いたしました新棟の速やかな整備・稼働を推進してまいります。加えて、半導体実装技術をもとに新たな事業領域を創出すべく、マーケティングおよび新商品開発体制を一層強化し、市場の成長・拡大を当社の成長に結びつけるべく注力いたします。また、パソコン向けやスマートフォン向けは、生産体制の合理化・効率化をさらに推進し、その技術・製品を成長分野・高付加価値分野に応用・展開することに注力するなど、収益確保に努めてまいります。

熾烈な競争が繰り広げられる半導体市場にあって、当社グループは、ものづくり、技術、サービスで常に先行し、市場・環境の変化に即応できる強靱な企業体質の構築をはかり、「限りなき発展」を果たしてまいります。

# 部門別の状況

## 部門別売上高構成

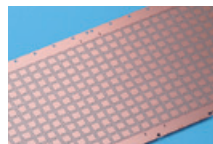


※ ( ) 内の数字は構成比率を表わしております。

### ICリードフレーム部門



プレスリードフレーム



QFNタイプ  
リードフレーム



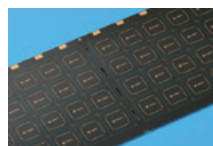
かしめリードフレーム

搭載製品例 スマートフォン、自動車、パソコン、家電・産業用他

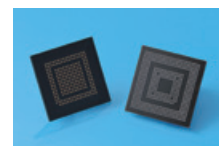
### ICパッケージ部門



フリップチップタイプ  
パッケージ



プラスチック  
BGA基板



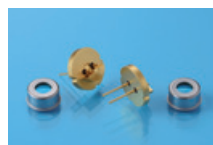
IC組立

搭載製品例 パソコン、サーバー、スマートフォン、民生機器他

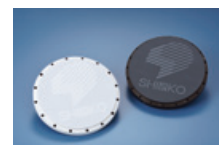
### 気密部品部門



センサー用ガラス端子



光素子用ガラス端子



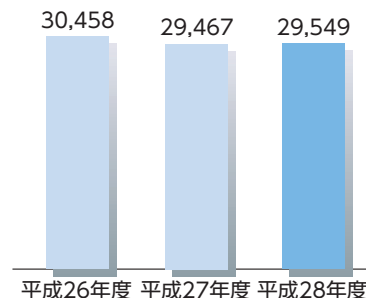
セラミック  
静電チャック

搭載製品例 自動車、半導体製造装置、民生機器、通信機器他

売上高 **295億49百万円**（前期比 ↑ 0.3%）

プレスリードフレームは、エレクトロニクス化が進む自動車向けの受注は底堅く推移したものの、在庫調整等の影響を受け、減収となりました。エッチングリードフレームは、QFN（クワッド・フラット・ノンリード）タイプがスマートフォン等向けの旺盛な需要のもと生産体制を強化したことなどにより、売上が増加しました。この結果、当部門の売上高は295億49百万円（対前期比0.3%増）となりました。

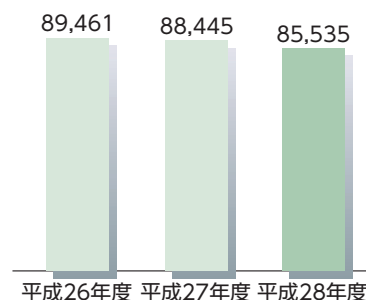
部門別売上高（百万円）



売上高 **855億35百万円**（前期比 ↓ 3.3%）

アセンブリ事業においては、ハイエンドスマートフォン向けにIC組立の売上が大きく増加し、自動車向けのIC組立も好調に推移しました。プラスチックBGA基板は、スマートフォン等のメモリー向けや自動車向けに売上が増加した一方で、フリップチップタイプパッケージおよびヒートスプレッダーは、パソコン市場の需要減少等を背景とする競争激化や円高・ドル安の影響を受け、減収となりました。この結果、当部門の売上高は855億35百万円（対前期比3.3%減）となりました。

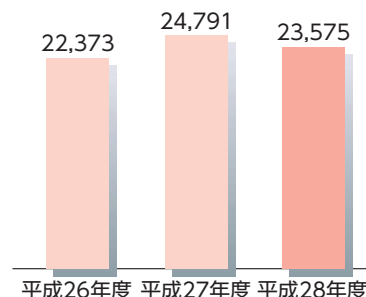
部門別売上高（百万円）



売上高 **235億75百万円**（前期比 ↓ 4.9%）

センサー用ガラス端子は、自動車向けの需要が低調のまま推移しましたが、光素子用ガラス端子は、光学機器向けに売上が増加しました。半導体製造装置向けセラミック静電チャックは、在庫調整ならびに円高・ドル安の影響を受けましたが、期後半にかけて受注が大きく増加しました。この結果、当部門の売上高は235億75百万円（対前期比4.9%減）となりました。

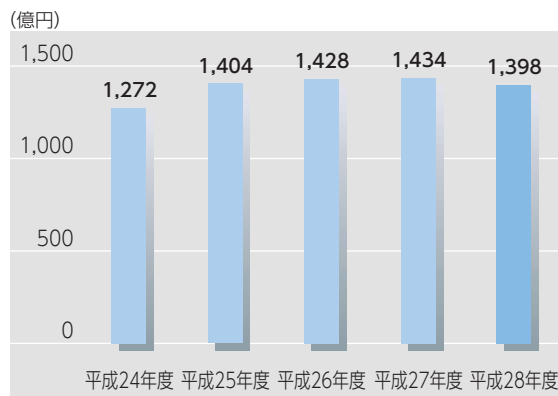
部門別売上高（百万円）



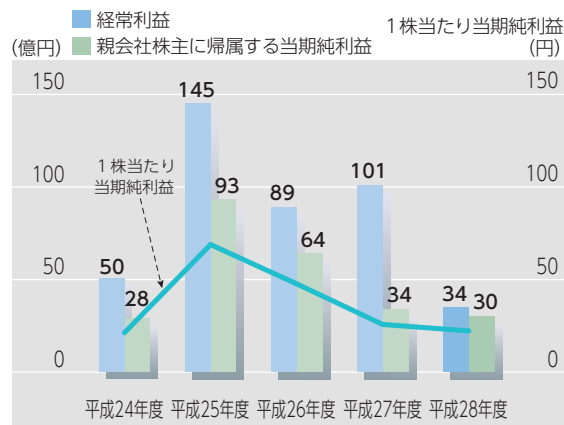
# 業績の推移

〔連結〕

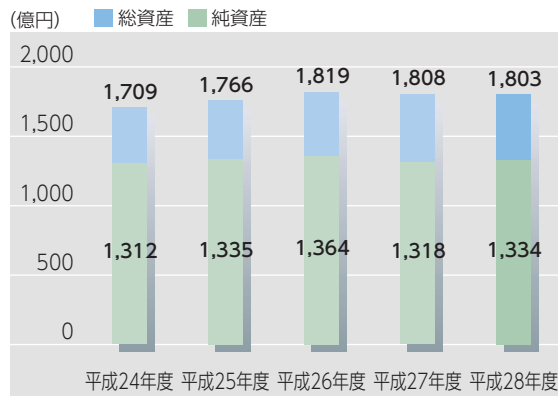
## ■ 売上高



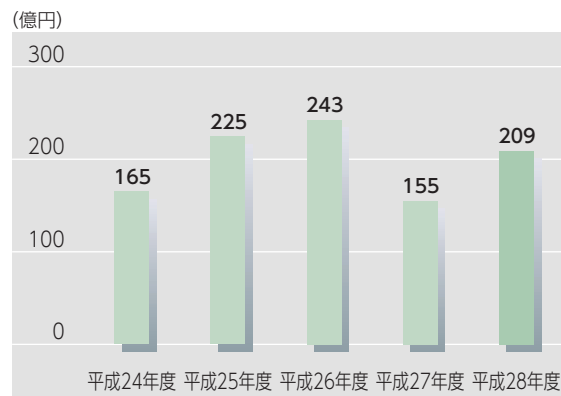
## ■ 経常利益／親会社株主に帰属する当期純利益



## ■ 総資産／純資産

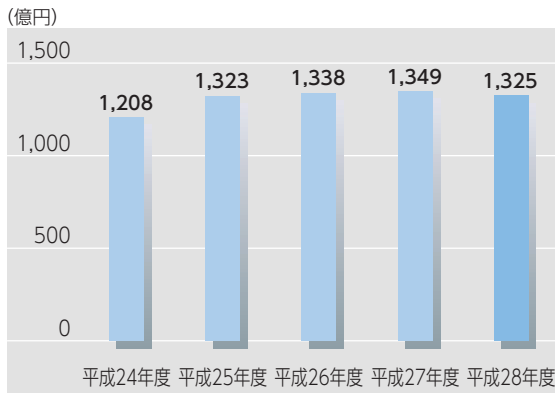


## ■ 設備投資

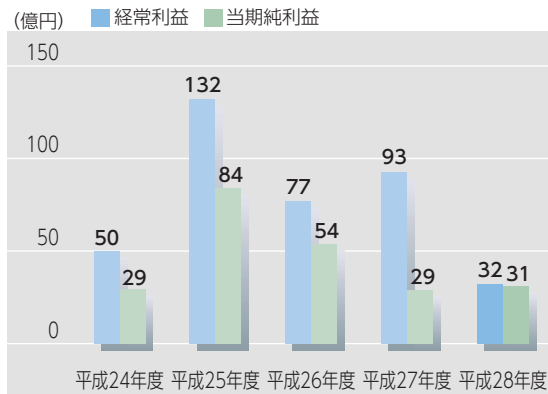


## 〔単独〕

## ■ 売上高



## ■ 経常利益／当期純利益



## ■ 営業成績および財産の状況の推移

| 区 分                   | 年 度 | 平成24年度<br>〔第78期〕 | 平成25年度<br>〔第79期〕 | 平成26年度<br>〔第80期〕 | 平成27年度<br>〔第81期〕 | 平成28年度<br>〔第82期 (当期)〕 |
|-----------------------|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 〔連結〕                  |     |                  |                  |                  |                  |                       |
| 売 上 高 (百万円)           |     | 127,241          | 140,412          | 142,815          | 143,453          | 139,890               |
| 経 常 利 益 (百万円)         |     | 5,049            | 14,501           | 8,973            | 10,135           | 3,468                 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円) |     | 2,874            | 9,309            | 6,442            | 3,476            | 3,007                 |
| 1 株 当 たり 当 期 純 利 益    |     | 21円28銭           | 68円91銭           | 47円69銭           | 25円74銭           | 22円26銭                |
| 総 資 産 (百万円)           |     | 170,966          | 176,651          | 181,903          | 180,886          | 180,339               |
| 純 資 産 (百万円)           |     | 131,206          | 133,536          | 136,407          | 131,834          | 133,435               |
| 1 株 当 たり 純 資 産        |     | 971円25銭          | 988円50銭          | 1,009円75銭        | 975円90銭          | 987円75銭               |
| 設 備 投 資 (百万円)         |     | 16,596           | 22,508           | 24,324           | 15,508           | 20,973                |
| 研 究 開 発 費 (百万円)       |     | 4,231            | 4,218            | 3,946            | 3,643            | 3,499                 |

## 〔単独〕

|                 |         |         |         |         |         |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 売 上 高 (百万円)     | 120,867 | 132,302 | 133,898 | 134,960 | 132,504 |
| 経 常 利 益 (百万円)   | 5,008   | 13,280  | 7,717   | 9,319   | 3,247   |
| 当 期 純 利 益 (百万円) | 2,943   | 8,435   | 5,497   | 2,958   | 3,173   |

# 決算概要（連結）

## Financial Statements(Consolidated)

### ■ 連結貸借対照表

平成29年3月31日現在

| (単位：百万円)    |         |         | (単位：百万円)    |          |          |
|-------------|---------|---------|-------------|----------|----------|
| 科 目         | 当 期     | 前 期     | 科 目         | 当 期      | 前 期      |
| 資 産 の 部     | 180,339 | 180,886 | 負 債 の 部     | 46,904   | 49,052   |
| 流 動 資 産     | 101,273 | 104,036 | 流 動 負 債     | 34,154   | 34,771   |
| 固 定 資 産     | 79,066  | 76,850  | 固 定 負 債     | 12,749   | 14,280   |
| 有 形 固 定 資 産 | 72,633  | 70,648  | 純 資 産 の 部   | 133,435  | 131,834  |
| 無 形 固 定 資 産 | 1,197   | 1,136   | 株 主 資 本     | 143,822  | 144,192  |
| 投資その他の資産    | 5,235   | 5,065   | 資 本 金       | 24,223   | 24,223   |
| 資産合計        | 180,339 | 180,886 | 資 本 剰 余 金   | 24,129   | 24,129   |
|             |         |         | 利 益 剰 余 金   | 95,562   | 95,932   |
|             |         |         | 自 己 株 式     | △ 92     | △ 92     |
|             |         |         | その他の包括利益累計額 | △ 10,387 | △ 12,358 |
|             |         |         | 負債純資産合計     | 180,339  | 180,886  |

### ■ 連結損益計算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日

| (単位：百万円)        |         |         |
|-----------------|---------|---------|
| 科 目             | 当 期     | 前 期     |
| 売 上 高           | 139,890 | 143,453 |
| 売 上 原 価         | 124,222 | 121,611 |
| 売 上 総 利 益       | 15,668  | 21,842  |
| 販売費及び一般管理費      | 12,399  | 12,420  |
| 営 業 利 益         | 3,268   | 9,422   |
| 営 業 外 収 益       | 638     | 1,095   |
| 営 業 外 費 用       | 438     | 382     |
| 経 常 利 益         | 3,468   | 10,135  |
| 特 別 損 失         | 434     | 3,977   |
| 税金等調整前当期純利益     | 3,034   | 6,157   |
| 法人税、住民税及び事業税    | 491     | 2,452   |
| 法 人 税 等 調 整 額   | △ 464   | 228     |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 3,007   | 3,476   |

### ■ 連結キャッシュ・フロー計算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日

| (単位：百万円)         |          |          |
|------------------|----------|----------|
| 科 目              | 当 期      | 前 期      |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,489   | 25,290   |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 17,653 | △ 16,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 3,444  | △ 3,771  |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △ 499    | △ 829    |
| 現金及び現金同等物の増減額    | △ 1,107  | 4,017    |
| 現金及び現金同等物の期首残高   | 48,355   | 44,337   |
| 現金及び現金同等物の期末残高   | 47,248   | 48,355   |

## 新井工場に新棟が竣工

本年3月、新井工場（新潟県妙高市）内に新棟が竣工しました。

当社では、1990年代後半から、大型汎用コンピューター向けの多層セラミックパッケージの技術を応用し、半導体製造装置向けセラミック静電チャックの製造を行っています。今後も旺盛な需要が見込まれることから、生産体制強化をはかるため、新たな生産拠点として新井工場に新棟を建設し、今年度下期からの稼働開始を目指し整備を進めています。

新棟では、今後の増産や新製品の量産化に効率的に対応するため、材料調合から製品出荷までを行う一貫工場を構築していく予定です。今後ともお客様の多様なニーズに柔軟にお応えすることで、一層の拡販を目指してまいります。



新井工場新棟

## 自動車の「安全・安心・快適」を支える半導体パッケージ

事故を未然に防ぐ運転支援システムの進展や、通信ネットワークを介してさまざまな情報サービスが展開されるなど、カーエレクトロニクスを取り巻く環境は大きく変化しています。

自動車に搭載されるICも飛躍的に増加しており、自動車の「安全・安心・快適」を支える製品として、数多くの当社グループの半導体パッケージが使用されています。

自動車の駆動系・電装系制御用に搭載されるIC向けには、リードフレームやプラスチックBGA基板などを供給しています。また、ナビゲーションや情報通信サービスなどのインフォテインメント向けにIC組立を行っており、安全走行系などの各種センサーには当社グループのリードフレームやガラス端子が幅広く用いられています。



自動車に搭載される当社グループの製品

# 会社の概要

## Corporate Data

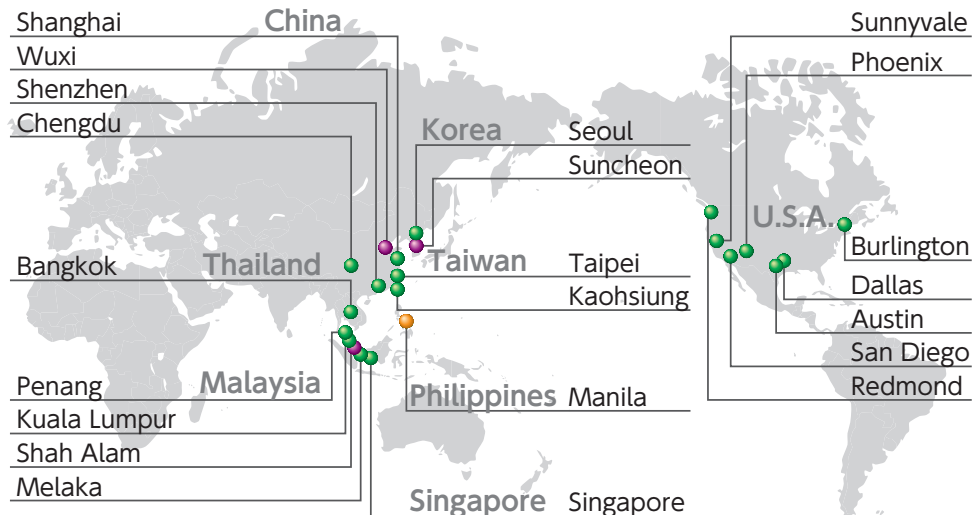
(平成29年3月31日現在)

## 取締役

(平成29年6月27日現在)

- 商 号 新光電気工業株式会社
- 設立年月日 昭和21年9月12日
- 本 社 長野県長野市小島田町80番地  
電話 (026) 283-1000〔代表〕
- 主な事業内容 リードフレーム、プラスチック・ラミネート・  
パッケージ、ガラス端子などの製造・販売、  
ICアセンブリ
- 従業員数 4,037名 (連結4,848名)
- 工場等 更北、若穂、高丘、新井、京ヶ瀬、  
新光開発センター、栗田総合センター
- 営業所等 東京、大阪、仙台、長野、名古屋、大分、福岡、  
マニラ
- グローバルネットワーク

|               |         |
|---------------|---------|
| 代表取締役会長兼社長    | 豊 木 則 行 |
| 代表取締役 専務執行役員  | 長 谷 部 浩 |
| 取 締 役 専務執行役員  | 依 田 稔 久 |
| 取 締 役 常務執行役員  | 小 平 正 司 |
| 取 締 役 常務執行役員  | 小 澤 隆 史 |
| 取 締 役 常勤監査等委員 | 小 川 喜 彦 |
| 取 締 役 監査等委員   | 北 澤 光 二 |
| 取 締 役 監査等委員   | 佐 伯 里 歌 |



●営業拠点 ●駐在員事務所 ●生産拠点

# 株式の状況

## Shareholders' Data

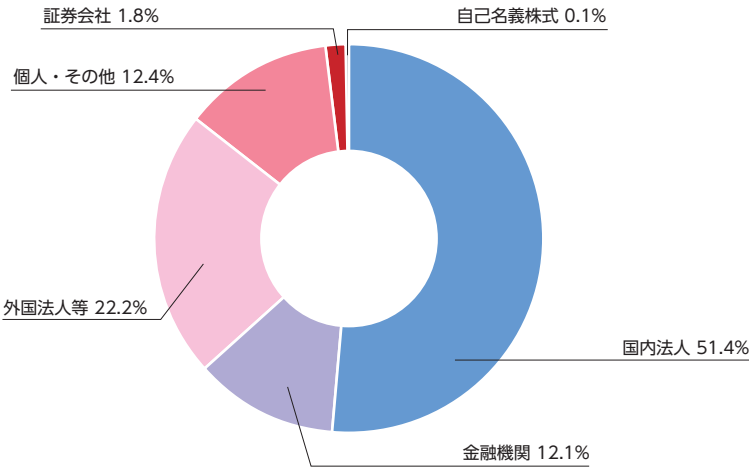
(平成29年 3月31日現在)

|           |              |      |                 |
|-----------|--------------|------|-----------------|
| ■発行可能株式総数 | 540,000,000株 | ■資本金 | 24,223,020,480円 |
| ■発行済株式の総数 | 135,171,942株 | ■株主数 | 14,438名         |
| ■大株主      |              |      |                 |

| 株主名                                        | 所有株式数<br>(千株) | 出資比率<br>(%) |
|--------------------------------------------|---------------|-------------|
| 富士通株式会社                                    | 67,587        | 50.00       |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY        | 2,796         | 2.07        |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口)                 | 2,558         | 1.89        |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)                   | 2,376         | 1.76        |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口9)                | 1,837         | 1.36        |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 1,837         | 1.36        |
| 株式会社八十二銀行                                  | 1,836         | 1.36        |
| CBNY DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO    | 1,782         | 1.32        |
| CBNY-GOVERNMENT OF NORWAY                  | 1,541         | 1.14        |
| THE BANK OF NEW YORK 133522                | 1,504         | 1.11        |

## 所有者別株式分布状況

(平成29年 3月31日現在)



## 株式事務のご案内

### ■株主名簿管理人および特別口座の口座管理機関

(連絡先)

〒100-8212  
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号  
三菱UFJ信託銀行株式会社  
〒137-8081  
東京都江東区東砂七丁目10番11号  
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部  
電話 0120-232-7111 (通話料無料)

### ■事業年度

4月1日から翌年3月31日まで

### ■基準日

定時株主総会関係  
配当金受領株主確定日

3月31日  
3月31日および中間配当金の支払いを行う  
ときは9月30日

### ■公告方法

電子公告  
当社は、公告を下記ホームページに掲載して  
おります。

<http://www.shinko.co.jp/ir/kk/>

ただし、事故その他やむを得ない事由によつて  
電子公告による公告をすることができない  
場合は、日本経済新聞に掲載いたします。

(ご注意)

1. 株主様の住所変更、配当金の振込みのご指定、買取請求その他の各種  
お手続きにつきましては、口座を開設されている口座管理機関（証券  
会社等）にお問い合わせください。
2. 特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、  
三菱UFJ信託銀行が口座管理機関となっておりますので、上記の連  
絡先にお問い合わせください。三菱UFJ信託銀行全国各支店におい  
てもお取り扱いいたします。
3. 未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払  
いたします。



新光電気工業株式会社

〒381-2287 長野県長野市小島田町 80 番地  
電話(026)283-1000〔代表〕FAX(026)284-8861  
<http://www.shinko.co.jp>



見やすいユニバーサルデザイン  
フォントを採用しています。



地球環境に配慮した植物油  
インキを使用しています